

코텍은 다양한 표면처리기술을 전문적으로 보유하고 있으며 다양한 표면처리품목 생산을 위한 개발과 품질관리에 힘쓰고 있습니다.



생산 품목 및 적용

분야/소재		항공, 방산, 원자력, 전기, 전자 / Fe, STS, Al, Cu	
용 도		납땜할 부품, 전기전도도 향상 제품, 전기접촉부 제품	
두께 (일반기준)		1~30μm 이상	
적용 규격	국방 0115-0015(연) AMS QQ-S-365 ASTM B 700 KSD 8339	두께	최소 12.5μm ↑
		밀착성	소재와 도금층의 분리흔적 없을 것
		수소취성제거	소재 조직상태와 경도에 따라 취성시간이 달라짐 191±14°C, 3hrs 이상 (HRC 32~39) 191±14°C, 12hrs 이상 (HRC 40~47) 191±14°C, 22hrs 이상 (HRC 48 이상)
		납땜성 시험	도금표면에 덩어리가 생기지 않고 균일하게 납땜 밀착성 시험시 부서지거나 떨어지지 말 것
승인현황		국외기업	HAMILTON
		국내기업	두원중공업, 한화디펜스, 한화탈레스, KAI, LIG넥스원, 국방과학연구소

설비현황

(주)코텍	800 × 600 × 1,200 mm
	1,600 × 600 × 1,000 mm
	9,000 × 200 × 350 mm

은도금

복잡한 형상 부분 작업 가능

보유기술별 특성 및 적용제품

경도

기본 조성만의 욕에서 얻어지는 은도금의 경도는 Hv70~90이지만 이것에 광택제를 가하여 결정질을 바꾸게 되면 Hv110~130으로 상승한다. 그러나 다른 금속을 경화제로 미량 공석 시키면 Hv140~160 까지도 가능하다.

윤활성

은도금의 윤활성은 비교적 양호하지만, 경도를 올리면 오히려 나쁘게 되는 경우가 많다.

전도도

순은에 비하여 도금된 은은 약간 저항이 높으며, 이는 동 또는 알루미늄 정도의 저항값을 가진다.

납땀성

은은 납땀성이 우수하여 반도체 분야에 많이 사용된다.

내변색성

변색은 피할 수 없지만 변색을 어느 정도 막으려면 크로메이트 유기물 처리 또는 기타 코팅 등으로 처리해 줄 필요가 있다.



위 도금공정은 주식회사 코텍의 콘텐츠이므로 무단복제 및 도용을 금합니다.

코텍 도금 공정



공정도

